证券代码：300672　　证券简称：国科微　　公告编号：2025-025

湖南国科微电子股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：300672　　证券简称：国科微　　公告编号：2025-031

湖南国科微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2160号文《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35,258,918股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用42,549,091.33元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2,252,101,292.11元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月28日出具了XYZH/2022CSAA3B0004号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计投入1,198,021,681.11元，募集资金累计获得利息收入19,754,039.88元，尚未使用募集资金余额为1,073,833,650.88元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2024CSAA3F0458号《湖南国科微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年度，公司募集资金使用总额为495,598,663.59元，尚未使用募集资金余额为605,537,637.75元（含利息收入和理财收入27,302,650.46元）。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年1月1日尚未使用募集资金余额	1,073,833,650.88
减：本期使用募集资金	495,598,663.59
其中：置换预先投入募集资金项目剩资金	0.00
直接投入募投项目的金额	495,598,663.59
加：扣除手续费的利息收入	27,302,650.46
2024年12月31日尚未使用募集资金余额（注）	605,537,637.75

注：2024年12月31日尚未使用募集资金余额中包含公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额600,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、长沙农村商业银行股份有限公司远大支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行及保荐机构天风证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	0.00	4,183,924.34	4,183,924.34
中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200188000083038	0.00	20,712.76	20,712.76
中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行	593779352371	0.00	1,630.84	1,630.84
中信银行股份有限公司长沙分行	8111601011700636474	0.00	761,901.35	761,901.35
长沙农村商业银行股份有限公司远大支行	82010100003855815	0.00	118,836.75	118,836.75
招商银行股份有限公司长沙开福支行	731904131210555	0.00	148,181.96	148,181.96
中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行	43050175443600002172	0.00	136,783.23	136,783.23
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000001137	0.00	165,666.52	165,666.52
合计		0.00	5,537,637.75	5,537,637.75

注：截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金专户余额605,537,637.75元，与募集资金账户余额相差600,000,000.00元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额600,000,000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金实际使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	签约方	银行账号	产品名称	产品期限	持有天数	认购金额	收益情况	期末的投资余额	募集资金是否如期归还
1	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	大额存单	3年	730	320,000,000.00	19,812,444.48	0.00	是
2	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	大额存单	3年	733	80,000,000.00	4,973,777.76	0.00	是
3	中国农业银行股份有限公司长沙县支行	18030901040034632	大额存单	3年	748	300,000,000.00		300,000,000.00	尚未到期
4	中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200181000003953	大额存单	3年	746	300,000,000.00		300,000,000.00	尚未到期
合计						1,000,000,000.00	0.00	600,000,000.00	—

注1：公司在中国农业银行股份有限公司长沙县支行购买的大额存单产品期限为3年，但可提前多次支取，提前支取起点金额为1,000.00万元。

注2：公司在中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行购买的大额存单产品期限为3年，但自2022年12月16日起息日后15个自然日（含）起可办理提前支取。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

六、备查文件

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南国科微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

2、《天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年4月24日

附表1

募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		225,210.13		本年度投入募集资金总额			49,559.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			169,362.04			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目	否	81,393.64	81,393.64	20,115.85	52,202.91	64.14	2025年	—	—	否
2、4K／8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目	否	75,016.49	75,016.49	29,444.02	48,359.13	64.46	2025年	—	—	否
3、补充流动资金及偿还银行借款	否	68,800.00	68,800.00	0.00	68,800.00	100.00	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	225,210.13	225,210.13	49,559.87	169,362.04	75.20	—	—	—	—
超募资金投向	不适用。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年12月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币34,029.71万元，及已支付发行费用的自筹资金人民币204.35万元。本次置换金额合计34,234.06万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《湖南国科微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（XYZH/2022CSAA1F0022号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年12月30日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币6亿元（含）。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但获取的收益进行再购买，再购买的金额不包含在初始购买金额内。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。保荐机构天风证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金中5,537,637.75元存放于募集资金专户，600,000,000.00元存放于大额存单账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

证券代码：300672　　证券简称：国科微　　公告编号：2025-036

湖南国科微电子股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据未来业务发展的需要，2025年度需与公司关联方芯盛智能科技（湖南）有限公司（原名“江苏芯盛智能科技有限公司”）及其子公司（以下简称“芯盛智能及其子公司”）发生日常关联交易，预计在2025年度公司（含分、子公司）将向芯盛智能及其子公司销售原材料及货物或提供技术开发服务，预计金额为4,000万元；提供租赁服务，预计金额为200万元；预计总金额4,200万元。预计将接受芯盛智能及其子公司采购原材料及货物或测试服务，预计总金额为300万元。

公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟庆一回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）2025年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	截至审议日已发生金额
向关联人销售商品或提供劳务	芯盛智能及其子公司	销售原材料及货物、提供技术开发服务	市场价	4,000万元	487.12万元
向关联人提供租赁服务	芯盛智能及其子公司	提供房屋租赁、物业管理等	市场价	200万元	0万元
接受关联人提供的原材料及货物或劳务	芯盛智能及其子公司	采购原材料及货物、接受测试服务	市场价	300万元	16.58万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务的比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
销售商品、提供劳务	芯盛智能及其子公司	集成电路研发及设计服务	0	200	0%	-100%	2024年4月25日于巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）
销售商品、提供劳务	芯盛智能及其子公司	销售原材料及货物	2657.73	6,500	88.02%	-59.11%	
采购商品、接受劳务	芯盛智能及其子公司	集成电路技术开发及测试服务	91.08	500	0.37%	-81.78%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，我们认为：2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。公司2024年发生的日常关联交易均基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理、遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。						

注：芯盛智能及其子公司包括：芯盛智能科技（湖南）有限公司、山东芯盛智能科技有限公司、成都芯盛集成电路有限公司、芯盛智能科技有限公司。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：芯盛智能科技（湖南）有限公司（原名“江苏芯盛智能科技有限公司”）

法定代表人：马翼

注册资本：67,571.4505万元人民币

统一社会信用代码：91320412MA1WYDG51U

住所：长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋1701

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；通信设备销售；智能车载设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2024年12月31日，芯盛智能总资产64664.73万元，净资产-35065.20万元，2024年度营业收入32564.59万元，净利润-12193.90万元。

2、关联关系：因公司董事孟庆一先生在过去12个月内曾担任芯盛智能的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）条规定，芯盛智能为公司的关联公司。

3、履约能力分析：芯盛智能依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。

2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：

（1）提供劳务的价格不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于同一报价机制收费。

（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费。

（3）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方提供同类的服务或商品的价格或收费标准。

3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。

4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2025年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与上述关联方的日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

经核查相关资料，我们认为2025年度预计的日常关联交易事项均基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理、遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：300672　　证券简称：国科微　　公告编号：2025-034

湖南国科微电子股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司2025年第一季度报告全文已于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：300672　　证券简称：国科微　　公告编号：2025-028

湖南国科微电子股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国科微	股票代码	300672
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄然	叶展	
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号	
传真	0731-88596393	0731-88596393	
电话	0731-88218880	0731-88218891	
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于超高清智能显示、智慧视觉、人工智能、车载电子、物联网、固态存储等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。

公司的主营产品包括直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、泛屏商显芯片、智慧视觉芯片、端侧人工智能芯片、无线局域网芯片、车载SerDes芯片、卫星导航定位芯片、固态存储控制器芯片及相关产品等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。公司产品主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。基于公司在无线连接领域的技术积累，公司物联网业务已拓展至无线局域网网卡芯片领域。同时，公司正积极拓展AI PC、机器人等端侧人工智能领域、车载数据传输等领域。

（二）报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势及下一报告期内下游应用领域的宏观需求

1、超高清智能显示领域：

视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）普及，同时向XR及智能化场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

2021年2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播，全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。

2022年1月，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日，北京冬奥会开幕，中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播，给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月，在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市70多个城市的270余块户外地标大屏，同步直播了总台8K中秋晚会信号，为各地观众送上美轮美奂的超高清观赏体验。

在2023年杭州亚运会和成都世界大学生运动会中，8K直播将精彩的比赛更加细腻生动地展现在观众眼前。公司全系列芯片都支持HDR VIVID、Audio VIVID等国产标准，为国产技术的落地应用起到了积极的推动作用。

近年来随着“全国一网”“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成，4K终端稳步发展，有线电视行业将会迎来全新发展机会，公司的4K芯片已经导入除西藏自治区以外的各省、市、自治区，并已经按规模稳定出货。2022年6月21日，国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，意见指出，自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，基本关停标清节目，这标志着从2025年开始，直播卫星将迎来一波换机潮，由标清过渡到高清和超高清。

2021年，公司针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片，于2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。2023年1月，中国移动启动IPTV机顶盒集采招标，采用公司IPTV芯片的厂商中标份额超过34%，公司取得了较大的释放份额，目前在大部分省份已经落地，正在大规模稳定出货中。另外，在中国联通2023年的集采中，公司所占份额超过50%，公司已于2024年基本完成中标份额的供货。在此过程中，公司积累了大量的各省软硬件适配和运营商招标落地工作经验，为深耕运营商市场打下了坚实基础。公司直播星4K智能机顶盒芯片及方案已在零售和个别省份的招标市场有一定出货，为2025年的大规模出货打下了坚实基础。

2024年，公司旗下共有5款产品通过鸿蒙4.0生态产品兼容性认证，全面拥抱国产生态；鸿蒙5.0项目已经在商显产品芯片中立项启动开发，预计2025年上半年产品开始导入。鸿蒙生态将是公司未来发力的重点方向之一。

2024年4月，第83届中国教育装备展示会在重庆召开，多款搭载公司4K/8K超高清显示芯片的教育类电子白板等产品亮相展会，为用户带来卓越的显示交互体验。

公司已通过自主研发积累了大规模SoC芯片设计技术、视频编解码技术、NPU技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术。目前，公司超高清智能显示类产品涵盖卫星、有线、地面、IPTV/OTT及TV和泛屏商显等领域，产品线丰富，种类齐全。同时，公司正在基于现有音视频芯片，规划和开发AI芯片，AI芯片覆盖传统音视频行业的新一轮AI产业升级需求。

2、智慧视觉领域：

公司智慧视觉系列芯片产品主要应用于安防行业中的视频监控领域。视频监控主要包括前端摄像机设备及后端录像机设备。前端设备主要为模拟摄像机和网络摄像机，核心部件分别包括一颗ISP芯片和IPC SoC芯片；后端设备主要为NVR/DVR，分别内置一颗NVR SoC芯片和DVR SoC芯片。

随着全球传统安防正在向智能（AI+）安防转变，IPC SoC芯片的出货量也在逐步增加。数据显示，2024年全球IPC SoC芯片的出货量超过了30,000.00万颗，其中，中国IPC SoC芯片的出货量达到了14,000.00万颗，海外市场增长迅速。根据赛迪顾问预测，预计到2026年全球IPC SoC芯片的市场规模将达到10.06亿美元，中国IPC SoC芯片的市场规模将达到8.15亿美元。

在安防监控领域，随着高清化、智能化的长期演进，人工智能在行业内得到更多的应用。近年来，人工智能产业正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间迅速发展，成为新的重要经济增长点。习近平总书记曾指出：“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。随着我国城镇化进程的进一步发展，智慧城市建设将进一步推动智能安防领域芯片的市场需求。

为满足市场需求，公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，进一步提升不同细分市场的产品竞争力。报告期内，为进一步满足市场智能化升级趋势，公司积极进行产品布局，完成了从传统/行业安防（带算力和不带算力）及消费类IPC从高端到低端的完整全系列自研产品规划，产品更加丰富，客户覆盖范围更大。公司在原有普惠型智能5MP/4MP/3MP芯片大规模出货的基础上，持续迭代，研发了新一代带AI算力（全新ISP升级，集成了前沿AI-ISP技术、多目技术）具备性价比的全自研4K 7606V1产品，产品已于2024年第四季度推出，刚出道即在头部安防客户测试获得高度评价，CPU性能、传统ISP效果、AI-ISP效果达到了行业顶尖水平。公司同时立项了经济款AI-ISP和安防腰部产品，预计在2025年度第二季度推出极具性价比的产品。为适应消费类IPC市场的变化，公司规划了多目+AOV极具性价比的常电和低功耗系列7203V1芯片，对应产品预计在2025年第二季度推出。另外，为了扩大市场份额，公司在中低端消费类产品市场已有对应的项目立项，预计在2025年推出。作为SVAC联盟成员，公司积极跟进SVAC产业化趋势，将根据新国产编码发展趋势，在合适时间点进行相关芯片的开发。

在鸿蒙生态领域，公司的智慧视觉系列产品均有配套鸿蒙解决方案，并已在客户端实现量产出货。

3、车载电子领域：

中国汽车工业协会发布数据显示，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模，连续16年稳居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。汽车智能化迅速的发展，促进了传感器和显示屏安装数量的增多，数据传输和智能处理需求持续增强。

（1）车载AI芯片市场目前主要分为两大类，一类为大算力芯片，主要应用场景为域系统控制器（座舱域，智驾域，舱驾一体等）；一类为小算力芯片，主要应用场景为相对单一的车载产品，如前向ADAS模组、智能行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜、360全景泊车、驾驶员和座舱监测系统等。

在大算力芯片市场，当前主要供应商为美国英伟达和美国高通，上述两家企业在大算力芯片市场领域占据领先，另外，国内地平线等企业也陆续有量产项目。小算力芯片算力大多在8TOPS及以下，目前，小算力芯片市场主要供应商有TI、安霸、地平线等。

（2）车载SerDes芯片具备大数据量、高速、低延迟、无损、远距离传输等特点，可广泛应用于传感器数据传输、显示屏数据传输，在智能座舱、智能驾驶等产品中发挥重要作用。随着汽车智能化发展，车载SerDes芯片发展潜力巨大。

目前美国两家企业（Maxim和TI）占据主要市场份额，近几年来也有部分初创企业开始进入这一领域，如上海慷智、天津瑞发科、南京仁芯科技等。车载业务场景对SerDes芯片要求极高，性能、功耗、EMC、ESD、可靠性、自适应性等维度都需要满足产品应用的需求。

公司主研芯片产品包括小算力车载AI芯片和高速SerDes芯片，目前形成了系列化芯片产品布局，通过扩展SerDes芯片的传输速率、数据通路数、接口种类，以及扩展车载AI芯片的算力、算法、接口种类，两类芯片可以形成360环视、CMS/OMS/DMS/DVR、智能驾驶、智能座舱等产品的完整解决方案。

4、人工智能领域：

2024年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这标志着人工智能将成为未来经济的重要发展引擎。人工智能的发展离不开算法础设施的支撑。

2025年政府工作任务中明确提出，激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。促进平台经济规范健康发展，更好发挥其在促创新、扩消费、稳就业等方面的积极作用。2025年两会更明确指出了人工智能的发展方向，其中明确提出“大模型+智能终端”的发展方向，同时随着以DeepSeek为代表的通用大模型技术及MoE、模型蒸馏等代表性大模型技术的发展和成熟，标志着AI大模型智能终端产业将迎来快速发展和应用。

近年来，人工智能大模型带来的技术创新和变革突破了传统人工智能小模型的技术瓶颈和应用边界，推动了人工智能应用的蓬勃发展。

2023年，公司提出“ALL IN AI”战略，聚焦人工智能边缘计算AI SoC研发，基于大模型+SoC赋能智能终端大模型应用。2024年，公司围绕“ALL IN AI”战略，聚焦人工智能边缘计算智能终端应用，解决传统NPU芯片大模型推理效率不足问题，公司创新提出MLPU芯片概念（面向多模态大模型的新型AI芯片架构），既能高效支持大模型推理计算，同时兼容传统小模型的高效推理。基于MLPU创新架构设计，公司形成了从16TOPS至100TOPS的智能终端AI SoC系列产品规划，形成了低中高AI SoC布局并已投入研发，主要应用于机器人（含具身智能）、AI PC、无人机、工业计算等边缘计算智能终端，预计2026年开始逐步量产上市。MLPU创新架构具有高能效、低功耗、高性价比的特点，相比于市面已有的NPU芯片，能够更高效的支持大模型的端侧部署和推理应用，从而保证模型推理效率和应用效果；为智能终端大模型应用带来变革性的创新AI芯片平台，激发智能终端创新。

同时，基于MLPU的创新架构设计，公司积极布局AI生态建设。公司围绕大模型及其大模型产品，深度优化适配，提供从模型压缩转化、推理部署、应用开发端到端全栈大模型工具链，方便开发者和客户能够简单高效的完成模型部署和应用开发，打造更具通用性、可用性和应用性的AI SoC系列产品。

5、物联网领域：

无线局域网是一种使用无线通信技术连接计算机网络的方式，目前已经广泛应用于日常生活中，是一种设备间传递数据的便捷通信方式。目前，无线局域网技术正在向着高速高带宽低延时的技术方向演进，最新的无线局域网技术的通信带宽高达320MHz，最高速率可以达到30Gbps，AP单设备的延时可以稳定在3ms以内。无线局域网技术的发展催生出新的应用，这将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，可有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

近年来，无线局域网在认证、安全和网络性能等方面取得了显著的进步，技术的进步带来应用的蓬勃发展和产业的繁荣，具体的驱动力主要有以下几点：1、互联互通技术的快速发展从根本上改变Wi-Fi产业的生态系统，推动运营商、公共场所服务商、互联网企业间建立Wi-Fi漫游关系，形成Wi-Fi漫游联盟；2、网络性能及容量显著提升，应用范围显著扩展，对于网络运营商来说，其对Wi-Fi网络的技术需要包括出色的传输速度、网络容量和网络密度，以满足数据流量迅猛上升的客观需求；3、移动互联网和物联网技术的迅猛发展驱动数据流量的中心从有